

[参加申込はこちら](#)

第 27 回エレクトロニクス実装学会春季講演大会プログラム

会期：平成 25 年 3 月 13 日（水）～15 日（金） 会場：東北大学 川内北キャンパス

第 1 日目（3 月 13 日）講演セッション（1/3）

	【A 会場】		【B 会場】		【C 会場】		【E 会場】		【F 会場】
10:30	<p>「部品内蔵基板技術」 座長：小岩一郎（関東学院大学） <b>13A-01 依頼講演</b> 部品内蔵技術委員会の活動と技術動向 ○見山克己（北海道工大）</p>	10:30	<p>「プリンタブルデバイス実装」 座長：西田秀行（ニシダエレクトロニクス実装技術支援） <b>13B-01 依頼講演</b> 真空技術を用いたスクリーン印刷工法の紹介 ○河田達哉，加藤芳郎（㈱野田スクリーン）</p>	10:30					
11:00	<p><b>13A-02 依頼講演</b> AT&amp;S の部品内蔵技術 ○GoetzingerSiegfried（AT&amp;S）</p>	11:00	<p><b>13B-02 依頼講演</b> PE とフレキシ印刷工法 ○中西正治（㈱コムラテック）</p>	11:00	<p>「高速高周波・電磁特性技術」 座長：齊藤義行（パナソニック㈱） <b>13C-01</b> SoC 動作が EMI（不要電磁輻射）に与える影響の評価、検討 ○入野 仁 1, 上村 篤 2, 佐々木英樹 1, 伊東伸行 1, 井部一隆 1, 鉾岩奈穂 1, 植西康隆 2, 吉川幸伸 2, 大野剛史 2, 平田昌義 1, 秋本哲也 1 (1:ルネサスエレクトロニクス㈱, 2:ルネサスマイクロシステム㈱)</p>				
				11:15	<p><b>13C-02</b> SoC 搭載プリント基板の EMI 見積り環境の開発 ○上村 篤 1, 入野 仁 2, 佐々木英樹 2, 伊東伸行 2, 植西康隆 1, 吉川幸伸 1, 大野剛史 1, 鉾岩奈穂 2, 井部一隆 2, 平田昌義 2, 秋本哲也 2 (1:ルネサスマイクロシステム㈱) 2:ネサスエレクトロニクス㈱)</p>				
11:30	<p><b>13A-03 依頼講演</b> 部品内蔵基板の国際標準化に向けた取組み ○友景 肇（福岡大学）</p>	11:30	<p><b>13B-03 依頼講演</b> PE とグラビアオフセット印刷の現状と課題 ○棟田明博，近藤直子（藤倉ゴム工業㈱）</p>	11:30	<p><b>13C-03</b> TEG チップ上に集積化した磁性薄膜による LTE 帯域内ノイズ抑制効果 ○室賀 翔 1, 樊 鵬 1, 遠藤 恭 1, 伊藤哲夫 1, 村上元己 2, 堀 和明 2, 高橋 寛 3, 田中 聡 4, 東 直也 5, 永田 真 5, 山口正洋 1 (1:東北大, 2:ルネサスエレクトロニクス, 3:ルネサスマバイル, 4:未定, 5:神戸大)</p>				
				11:45	<p><b>13C-04</b> 信号ジッタを低減するための電源インピーダンスの検討 ○海谷清彦 1, 金子俊之 1, 楠本学 2, 小川雅寿 2, 石田尚志 2 (1:㈱トッパン NEC サーキットソリューションズ, 2:NEC グリーンプラットフォームフォーム研究所)</p>				
12:00   13:00	休憩	12:00   13:00	休憩	12:00   13:00	休憩				

第1日目 (3月13日) 講演セッション (2/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】		【E会場】		【F会場】
13:00	<p>「部品内蔵基板技術」 座長：見山克己(北海道工業大学) <b>13A-04 依頼講演</b> 部品内蔵配線板の電気信号伝送特の優位性とスマホメインボードへの適用 ○福岡義孝1, 田中雅也2, 相楽秀次2, 笹岡賢二2 (1:ウェイスティール, 2:大日本印刷㈱)</p>	13:00	<p>「プリントデバイス実装」 座長：西田秀行(ニシダエレクトロニクス実装技術支援) <b>13B-04 依頼講演</b> PEにおける超微細インクジェットの可能性 ○村田和広 (㈱SIJテクノロジー)</p>	13:00	<p>「回路・実装設計技術」 座長：谷 貞宏(ST-Lab) <b>13C-05 依頼講演</b> 平衡・不平衡線路におけるグラウンドとEMC ○豊田啓孝(岡山大)</p>	13:00	<p>「電子部品・実装技術」 座長：三宅敏広(㈱デンソー) <b>13E-01 依頼講演</b> MEMS技術を利用した低侵襲医療ヘルスケア機器の開発 ○芳賀洋一, 松永忠雄 (東北大学)</p>	13:00	<p>「材料技術」 座長：宝蔵寺浩之(㈱日立製作所) <b>13F-01 依頼講演</b> フレキシブルプリント配線板のイノベーション技術 ○八甫谷明彦1, 宮脇学2 道脇茂2, 瀧井 秀吉2, 工藤孝廣3, 森邦夫3 (1:㈱東芝, 2:㈱メイコー, 3: ㈱いおう化学研究所)</p>
13:30	<p><b>13A-05</b> 部品内蔵電子回路基板の検査とCADツールの連携 ○山寄浩 (日置電機㈱)</p>	13:30	<p><b>13B-05 依頼講演</b> プリントブルエレクトロニクスのためのマイクロコンタクト印刷工法 ○山本典孝, 日下靖之, 安部浩司, 尾上美紀, 藤田真理子, 小倉晋太郎, 牛島洋史 (産業技術総合研究所)</p>	13:30	<p><b>13C-06</b> 金属被覆された不織布による電磁シールド効果 ○浅妻裕己1, 室賀 翔1, 田中智也2, 川村知之2, 加藤一史2, 山口正洋1 (1:東北大, 2:旭化成せんい㈱)</p>	13:30	<p><b>13E-02</b> 銅ハイブリットペーストによる高強度接合 ○山川智弘1, 下田将義1, 竹本正1, 西川 宏1, 塩川国夫2, 中谷誠登3, 上田雅行3, 後藤英之3 (1:大阪大学, 2:富士電機㈱, 3:ハリマ化成㈱)</p>	13:30	<p><b>13F-02</b> ベンゾオキサジン変性ビスマレイミドとシアン酸エステルから成る高耐熱性樹脂 ○岡本真, 大山俊幸, 高橋昭雄 (横浜国大院工)</p>
13:45	<p><b>13A-06</b> チップ部品の電極部への選択的無電解めっき膜形成 ○小岩一郎1, 中田龍之介1, 福井健太1, 渡辺宣朗2, 橋本 晃2 (1:関東学院大学工学部物質生命科学科, 2:関東学院大学工学総合研究所)</p>			13:45	<p><b>13C-07</b> シールド平衡ケーブルのピグテールによるシールド接地とノイズ耐性 ○渡邊陽介, 内田 雄, 佐々木雄一, 岡 尚人, 大橋英征 (三菱電機㈱)</p>	13:45	<p><b>13E-03</b> 各種金属に低温接合可能な銀ナノ粒子ペースト ○渡辺智文, 松居美紀, 下山賢治, 山田 充, 武居正史 (バンドー化学㈱)</p>	13:45	<p><b>13F-03</b> 熱カチオン硬化脂環式エポキシ樹脂の強硬化 ○外川一美, 大山俊幸, 高橋昭雄 (横浜国大院工)</p>
14:00	<p><b>13A-07</b> 部品内蔵基板の信頼性評価 ○加藤義尚1, 館 伸哉2, 韓榮建1, 堀内 整1, 崔 雲2, 友景肇2 (1:福岡大学半導体実装研究所, 2:福岡大学工学部電子情報工学科)</p>	14:00	<p><b>13B-06 依頼講演</b> プリントド・エレクトロニクス用ナノインクの開発の現状と課題 ○中許昌美(地方独立行政法人大阪市立工業研究所)</p>	14:00	<p><b>13C-08</b> 屈曲した差動信号線路における平衡度不整合理論に基づいたコモンモード抑制手法 ○松嶋 徹, 和田修己(京大)</p>	14:00	<p><b>13E-04</b> ナノ構造を持つめっき表面の低温接合 ○柴田康孝1, ZhangWenjing2, 藤野真久1, WangYinghui1, LiMing2, 須賀唯知1 (1:東京大学, 2:上海交通大学)</p>	14:00	<p><b>13F-04</b> カーボンナノチューブを用いたフレキシブル基板用ビアの作製とその評価 ○寺坂英矩1, 藤野真久1, 須賀唯知1, 曾我育夫2, 近藤大雄2, 石月義克2, 岩井大介2 (1:東京大学工学系研究科精密工学専攻, 2:富士通研究所)</p>
14:15	<p><b>13A-08</b> 圧接工法で接合したLSI内蔵基板の信頼性 ○石月義克1, 谷 元昭1, 熊谷欣一2 (1:㈱富士通研究所, 2:富士通セミコンダクター㈱)</p>			14:15	<p><b>13C-09</b> 貫通穴によるリターンパス不連続にもなう放射ノイズの抑制方法 ○野崎孝英, 中西秀行, 田中顕裕(アイカ工業㈱)</p>	14:15	<p><b>13E-05</b> 特異応力場の強さによる単純重ね合わせ継ぎ手のはく離強度の評価 ○宮崎達二郎1, 野田尚昭2, 李戎3, 内木場卓巳3, 佐野義一2 (1:琉球大, 2:九大院, 3:九大院)</p>	14:15	<p>休憩</p>
14:30	<p>休憩</p>	14:30	<p><b>13B-07 依頼講演</b> プリントド・エレクトロニクスにおける国際標準化 ○小田正明(次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合)</p>	14:30	<p>休憩</p>	14:30	<p>休憩</p>	14:30	<p>「材料技術」 座長：織壁 宏(味の素㈱) <b>13F-05</b> 表面活性化接合法における垂直配向カーボンナノチューブと金属薄膜の接触抵抗に関する考察 ○藤野真久1, 寺坂英矩1, 須賀唯知1, 曾我育夫2, 近藤大雄2, 石月義克2, 岩井大介2 (東京大1, ㈱富士通研究所2)</p>

第1日目 (3月13日) 講演セッション (3/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】		【E会場】		【F会場】
14:45	<p>「部品内蔵基板技術」 座長：加藤義尚 (福岡大学) 13A-09 内蔵受動部品の動向と今後の展望 ○青木仁 (KOA(株))</p>		13B07 依頼講演 (つづき)	14:45	<p>「高速伝送実装技術」 座長：田中元志 (秋田大学) 13C-10 動的電源電圧変動に対するSRAMコアの動作不良感度 ○澤田卓也 1, 高田英裕 2, 新居浩二 2, 永田真 1 (1:神戸大, 2:ルネサス エレクトロニクス(株))</p>	14:45	<p>「電子部品・実装技術」 座長：本多 進 (YJC) 13E-06 スクリーンオフセット印刷による微細配線の形成 ○野村健一 1, 牛島洋史 1, 三井亮介 2, 高橋誠哉 2, 中島伸一郎 2 (1:産総研, 2:日本航空電子工業(株))</p>	14:45	<p>13F-06 中間層を用いた表面活性化手法によるポリマー/ポリマーおよびポリマー/ガラス常温接合 ○松前貴司 1, 藤野真久 1, 重藤暁津 2, 松本好家 3, 須賀唯知 1 (1:東京大学, 2:物質・材料研究機構, 3:ランテックニカルサービス(株))</p>
15:00	<p>13A-10 部品内蔵基板の設計におけるCADツールの課題と対応 ○松岡宏志, 白鳥高之, 布施 武 (株ワイ・ディ・シー)</p>	15:00	休憩	15:00	<p>13C-11 次世代超高速 Long Reach 伝送技術開発について ○須和田 誠 (富士通アドバンステクノロジー)</p>	15:00	<p>13E-07 金めっき浴中における銅不純物の電解除去による管理技術に関する速度論的解析 ○伊達和宏 1, 吉原佐知雄 1, 野澤純一 2, 野尻尚克 2 (1:宇都宮大学大学院, 2:株大昌電子)</p>	15:00	<p>13F-07 GaN エピタキシャル膜中の転位に及ぼすダイシングプロセスの影響 ○田口秀幸 1, 2, 北原周 1, 三宅修吾 1, 中上明光 1, 藤原康文 2 (株コペルコ科研 1, 大阪大学 2)</p>
15:15	<p>13A-11 部品内蔵基板設計対応 CAD/CAM 技術と FUJIKO への期待 ○松澤浩彦 (株図研)</p>	15:15	<p>「検査技術」 座長：内山浩志 (富士ゼロックス (株)) 13B-08 パッケージ内に電極を内蔵したICの入力部断線の交流電界印加時の電流テスト ○小野安季良 1, 高木正夫 1, 四柳浩之 2, 橋爪正樹 2 (1:香川高等専門学校, 2:徳島大学)</p>	15:15	<p>13C-12 多ポートのミックスド・モード S パラメータ ○藤城義和, 越地耕二 (東京理科大学)</p>	15:15	<p>13E-08 フィルムデバイスの実装を志向した新規接続技術の開発 ○三井亮介 1, 高橋誠哉 1, 中島伸一郎 1, 野村健一 2, 牛島洋史 2 (1:日本航空電子工業(株), 2:産業技術総合研究所)</p>	15:15	<p>13F-08 液晶性有機半導体を用いた塗布型ボトムコンタクト有機FET ○木本正臣 1, 物部浩達 2, 清水洋 2 (1:奥野製薬工業(株), 2:産総研)</p>
15:30	<p>13A-12 SiPにおける3次元フォーマットの必要性 ○川瀬英路 (ケイレックス・テクノロジー(株))</p>	15:30	<p>13B-09 IEEE1149.1 検査機構を用いた双方向信号線の電気テスト法 ○橋爪正樹 1, 芥川正武 1, LuShyue-Kung 2, 四柳浩之 1 (1:徳島大, 2:国立台湾科技大学)</p>	15:30	<p>13C-13 差動信号用ペア配線に対するモード選択的損失抑制 ○山岸圭太郎 1, 石橋拓真 2, 明星慶洋 1 (1:三菱電機 (株), 2:三菱電機エンジニアリング (株))</p>	15:30	<p>13E-09 Cu/Ni/Cu 3層クラッド材を用いたリードフレームの開発 ○南部光司, 岡山浩直, 黒川哲平 (東洋鋼板(株))</p>	15:30	<p>13F-09 応答曲面モデルを利用した鉛フリーはんだの拡散抑制に有効な添加元素の探索技術 ○野中紀彦 1, 岩崎富生 1, 守谷浩志 1, 谷江尚史 1, 池田靖 2 (1:株日立製作所日立研究所, 2:株日立製作所横浜研究所)</p>
15:45		15:45	<p>13B-10 静電容量型プローブによる欠陥配線のイメージング ○野口祐智 (電機大)</p>	15:45	<p>13C-14 ガラスクロス多層配線板におけるスキュー分布が伝送特性に及ぼす影響の検討 ○長岡秀明, 福盛大雅, 水谷大輔 (株富士通研究所)</p>	15:45	<p>13E-10 60GHz 帯 Si-CMOS 送信 RF-IC モジュールにおけるフリップチップ実装前後による RF 特性比較 ○谷藤正一, 亀田 卓, 末松憲治, 高木 直, 坪内和夫 (東北大)</p>	15:45	<p>13F-10 Fe ナノ密着層の接合機構に関する研究 ○水野雄貴, 藤野真久, 須賀唯知 (東京大学)</p>
		16:00	<p>13B-11 濃淡方向を考慮した多値画像差方式配線パターン外観検査手法 ○原 靖彦 1, 田中宏卓 1, 滝沢義信 2, 菅野純一 2 (1:日本大学工学部, 2:ヴィスコ・テクノロジーズ(株))</p>	16:30		16:00	<p>13E-11 電磁誘導式 MEMS エアタービン発電機に用いる積層セラミック磁気回路についての検討 ○金子真人, 遠藤弘彬, 片山晃, 高藤美泉, 齊藤 健, 内木場文男 (日本大学理工学部)</p>	16:30	<p>13F-11 焼結銀を用いたパワー半導体素子の接合技術の開発 ○床尾尚也, 安藤拓司, 保田雄亮, 鈴木和弘, 紺野哲豊, 守田俊章 (株日立製作所日立研究所)</p>

## 第1日目【3月13日】ものづくりセッション D会場

	座長：井関裕二（㈱東芝）
10:30	<b>13D-01</b> 実装支援システム PC-Mount CAM の紹介 ○植谷剛実（ダイナトロン㈱）
10:50	<b>13D-02</b> マルチ CAD 対応製造設計システム：DFM Center の紹介 ○上矢健也（㈱図研）
11:10	<b>13D-03</b> 高速エッチングシミュレータによる基板生産のDFMフローの実現 ○堀江大輔（㈱OR テック）
11:30	<b>13D-04 依頼講演</b> 株式会社メイコー 宮城工場復興までの道程 ○今村圭男，芳野 明（㈱メイコー）

## 第1日目【3月13日】ポスターセッション ショートプレゼンテーション D会場

前半		後半	
座長：鈴木一高（太陽誘電モバイルテクノロジープロダクツ㈱）		座長：五百旗頭健吾（岡山大学）	
13：45	<b>13PD-01</b> 硫酸銅めっきに対する速度論的考察 ○山本祐也，齊藤貴之，松本克才（八戸高専）	15：00	<b>13PD-13</b> スイッチング DC-DC コンバータの逆回復電流の測定とモデル化 ○富永悠理 1，須藤俊夫 1，柳田進 2（1：芝浦工業大学，2：㈱ライズコーポレーション）
13：50	<b>13PD-02</b> 銅のウェットエッチングにおける界面活性剤の効果 ○畑中亮英 1，関下明日香 1，久保田賢治 2, 3，松本克才 1（1：八戸工業高等専門学校，2：宇都宮大学大学院，3：三菱マテリアル㈱）	15：05	<b>13PD-14</b> 電源 IC の過渡応答と周波数特性を正確かつ高速に解析する機能シミュレーション手法の開発 ○小館直人，古川達也，杉本泰博（中央大）
13：55	<b>13PD-03</b> 硫酸/過酸化水素水溶液による銅のエッチングに対するアルコール添加の効果 ○関下明日香 1，畑中亮英 1，久保田 賢治 2, 3，松本 克才 1（1：八戸工業高等専門学校，2：宇都宮大学大学院，3：三菱マテリアル㈱）	15：10	<b>13PD-15</b> 平行 2 線路上の磁性薄膜による伝導ノイズ抑制効果の配線インピーダンス依存性 ○倉石澄人，室賀翔，浅妻裕己，山口正洋（東北大学）
14：00	<b>13PD-04</b> 硫酸/過酸化水素水溶液における銅の溶解速度と腐食電位の関係 ○横山未歩，小井田剛，松本克才（八戸工業高等専門学校）	15：15	<b>13PD-16</b> CMOS プロセスを想定したインタディジタル結合線路と伝送線路を用いたミリ波有極形フィルタ ○谷井宏成 1，和田光司 1，牧本三夫 2，五十嵐貞男 3，福井邦明 3，小日向宏一 3（1：電通大，2：サクラテック㈱，3：アールエフ・チップス・テクノロジー㈱）
14：05	<b>13PD-05</b> ウェットエッチングにおける銅箔へのニッケル表面処理の効果 ○大坪賢明，奈良優樹，松本克才（八戸工業高等専門学校）	15：20	<b>13PD-17</b> RF スイッチを装荷した有極形周波数可変マイクロストリップ線路共振器の基本特性 ○Bui Manh Khoa 1，和田光司 2（1：システックリサーチインク㈱，2：電通大）
14：10	<b>13PD-06</b> オートマッピングロボットの試作 ○西佳一郎（八戸工業高等専門学校）	15：25	<b>13PD-18</b> UWB 用デュアルバンドモノポールアンテナの検討 福元俊吏 1，Emad Tammam 2，兼本大輔 1，○金谷晴一 1，吉田啓二 1，吉富邦明 2（1：九州大学，2：日本エジプト科学技術連携センター）
14：15	<b>13PD-07</b> 半導体実装用微細バンプ強度物性の微細組織依存性 ○遠藤史明，鈴木研，三浦英生（東北大）	15：30	<b>13PD-19</b> CMOS プロセスを用いた 60GHz 帯小型バンドパスフィルタの開発 石田竜也 1，○金谷晴一 1，ボカレル ラメシュ 2，兼本大輔 1，吉田啓二 1（1：九州大学，2：日本エジプト科学技術連携センター）
14：20	<b>13PD-08</b> 半導体三次元実装構造の製造工程内残留応力モニタリング技術の開発 ○多胡弘紀，鈴木研，三浦英生（東北大）	15：35	<b>13PD-20</b> 表皮効果を利用した磁性薄膜透磁率測定用平面型プローブ ○藪上信 1，佐藤彰 1，小澤哲也 1，宮澤安範 2，島田寛 3（1：東北学院大，2：東栄科学産業，3：東北大）
14：25	<b>13PD-09</b> IC チップレベルのノイズ結合評価を目的とした 3D 近傍磁界計測装置の開発 ○重田洋二郎，室賀翔，荒井薫，ドゥンガナサンディープ，奥田亮介，遠藤恭，山口正洋（東北大）	15：40	<b>13PD-21</b> 銀ナノ粒子インクを用いた薄膜電極の密着性向上と界面融着状態の解析 ○関根智仁 1，池田英昭 2，小坂井暁史 2，福田憲二郎 1，熊木大介 1，時任静士 1（1：山形大 ROEL，2：サンアロー（株））
14：30	<b>13PD-10</b> 3 次元積層 SiP の電源インピーダンスの解析・評価 ○川口翔平 1，佐藤正臣 1，高谷寛希 1，田中陽介 1，藤田陽也 1，須藤俊夫 1，坂井敦 2，内山士郎 2，池田博明 2（1：芝浦工業大学，2：超先端電子技術開発機構）	15：45	<b>13PD-22</b> 紙への半田めっきパターンの形成と RFID タグへの応用 ○坂井雄一 1，浅田峯夫 1，二口友昭 1，本田憲市 2，廣瀬慶一 2，猪田明宏 2（1：富山県工業技術センター，2：立山科学工業（株））
14：35	<b>13PD-11</b> 臨界制動特性をもつ PDN による電源ノイズの抑制効果 ○市村航，小林遼太，大塚史記，久保元樹，清重翔，寺崎正洋，須藤俊夫（芝浦工大）	15：50	<b>13PD-23</b> 導電性ペースト用受容層材料の熱硬化状態と耐久性 ○山下宗哲 1，高田浩平 2，的場哲也 2，宮崎崇 1，森一 1，前田拓也 1（1：和歌山県工業技術センター，2：新中村化学（株））
14：40	<b>13PD-12</b> 周波数特性を持つターゲットインピーダンスに関する考察 ○山口冬生，鳩貝裕介，須藤俊夫（芝浦工大）	15：55	<b>13PD-24</b> 高耐熱・低線膨張材料の設計とその特徴 ○宍倉朋子，和田吉世，兼松孝之（DIC（株））
14：45	休憩		

第2日目 (3月14日) 講演セッション (1/2)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
10:30	<p>「システムインテグレーション実装技術」 座長：高野 希 (日立化成 (株)) <b>14A-01</b> 自己組織化静電吸着技術を利用した三次元チップ積層 ○橋口日出登1, 福島誉史2, 藁 志哲2, 木野久志1, 李 康旭2, 田中徹1, 3, 小柳光正2 (1:東北大学大学院工学研究科, 2:東北大学未来科学技術共同研究センター (NICHe), 3:東北大学大学院医工学研究科)</p>	10:30	<p>「プリンタブルデバイス実装」 座長：西田秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支援) <b>14B-01 依頼講演</b> フレキシブルデバイスのバイオ医療応用 ○ 染谷隆夫, 関谷 毅 (東京大学, JST ERATO)</p>	10:30	<p>「回路・実装設計技術」 座長：越地福朗 (国士舘大学) <b>14C-01</b> プリント配線板に形成した EBG 構造の電磁特性の基礎検討 ○増井智大, 山本隆彦, 越地耕二 (東京理科大)</p>
10:45	<p><b>14A-02</b> ナノパーティクルデポジション法を用いた微細円錐金バンプ接合配列の作製と評価 ○根本俊介, 居村史人, 加藤史樹, 渡辺直也, 仲川 博, 青柳昌宏, 菊地克弥 (産総研)</p>			10:45	<p><b>14C-02</b> 平行平板共振抑制のための EBG 構造とフェライト膜を組み合わせた電源層の評価 ○竹井頌瑛1, 豊田啓孝2, マハムドファーハン ザヒド2, 五百旗頭健吾2, 近藤幸一3, 吉田栄吉3 (1:岡山大学工学部通信ネットワーク工学科, 2:岡山大学大学院自然科学研究科, 3:NEC トーキョー(株))</p>
11:00	<p><b>14A-03</b> 機能性液体を用いた自己組織化チップ実装技術 ○伊藤有香1, 2, 福島誉史3, 李 康旭3, 長木浩司2, 田中 徹1, 4, 小柳光正3 (1:東北大学大学院工学研究科, 2:住友ベークライト(株), 3:東北大学未来科学技術共同研究センター, 4:東北大学大学院医工学研究科)</p>	11:00	<p>座長：西 眞一 (コニカミノルタ IJ (株)) <b>14B-02 依頼講演</b> プリントドエレクトロニクスに向けた透明ハイブリッドフィルムの開発 ○宮下徳治 (東北大多元研)</p>	11:00	<p><b>14C-03</b> プリント配線板の給電配線パターンにおける CMRR 評価方法 ○島崎 睦1, 2, 西 慎矢1, 浅井秀樹2 (1:三菱電機(株), 2:静岡大学)</p>
11:15	<p>「ASET 特別発表コーナー」 <b>14A-04</b> 立体構造新機能集積回路 (ドリームチップ) 技術開発 ○小林治文 (超先端電子技術開発機構)</p>			11:15	<p><b>14C-04</b> 高多層プリント基板の電源配線設計手法 ○藤澤俊輔, 塚田晃子, 切中将樹 (富士通インターコネクテックテクノロジーズ(株))</p>
11:30	<p><b>14A-05</b> 三次元集積化技術におけるマイクロバンプ C2C 技術 ○末岡邦昭, 山田文明, 堀部晃啓, 松本圭司, 小原さゆり, 森 裕幸, 折井靖光, 菊池秀和, 武田健一 (超先端電子技術開発機構)</p>	11:30	<p>座長：西田秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支援) <b>14B-03 依頼講演</b> 印刷型有機 TFT 作製と集積回路応用 ○時任静士 (山形大)</p>	11:30	<p><b>14C-05</b> プリント配線板プレーン間に挿入した抵抗付きキヤパシタの消費電力への影響 齋藤 純, ○谷由紀夫, 高橋丈博, 澁谷 昇 (拓殖大学)</p>
11:45	<p><b>14A-06</b> 三次元集積化技術における熱解析, 放熱技術 ○山田文明, 松本圭司, 島山友行*, 末岡邦昭, 堀部晃啓, 小原さゆり, 森 裕幸, 折井靖光, 小林治文 (超先端電子技術開発機構, *:富山県立大学)</p>			11:45	<p><b>14C-06</b> 損失を有する 1/4 波長共振器による電源/グラウンド層間共振抑制 ○豊田啓孝, マハムドファーハン ザヒド, 五百旗頭健吾 (岡山大)</p>
12:00	<p><b>14A-07</b> 三次元実装における ICF ( NCF) 付きダイシングテープ技術 ○北市幸佑, 島本晴夫, 山田文明, 末岡邦明 (超先端電子技術開発機構)</p>	12:00   13:00	休憩	12:00 [ 13:00	休憩
12:15   13:00	休憩				

第2日目 (3月14日) 講演セッション(2/2)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
13:00	<p>「ASET 特別発表コーナー」 座長：折井靖光 (日本 IBM (株)) <b>14A-08</b> 薄ウエハにおけるCu汚染のCMOSデバイスへの影響 ○島本晴夫1, 齋藤滋晃1, 北市幸佑1, 安永尚司2, Kang Wook Lee3, 田中 徹3, 小柳光正3 (1:ルネサスエレクトロニクス(株), 2:ローム(株), 3:東北大学)</p>	13:00	<p>「プリンタブルデバイス実装」 座長：小田正明 ((株) アルバック) <b>14B-04</b> シリカコート金ナノ粒子のレーザ焼結による金属膜形成技術 ○山崎和彦, 浅本麻紀子, 前川克廣, 小林芳男 (茨城大)</p>	13:00	<p>「高速高周波・電磁特性技術」 座長：井上博文 (日本電気 (株)) <b>14C-07</b> 依頼講演 ESDに伴う広帯域過渡変動の測定と電磁ノイズの放射特性 ○川又 憲 (八戸工業大学)</p>
13:15	<p><b>14A-09</b> Via-Last/Back-Via方式TSV形成技術の開発 ○三橋敏郎, 菊地秀和, 柳澤あづさ, 内山士郎 (超先端電子技術開発機構)</p>	13:15	<p><b>14B-05</b> 金属ナノ粒子クラスター粉末のレーザ焼結配線法 ○高原 浩1, 前川克廣1, 山崎和彦1, 御田 護2 (1:茨城大, 2:M &amp; M研究所)</p>		
13:30	<p><b>14A-10</b> 積層チップのI/Oアクセスと回路の検討 ○古田 太, 長田健一, 武田健一 (超先端電子技術開発機構)</p>	13:30	<p><b>14B-06</b> 透明な紙を用いたプリンテッドペーパーエレクトロニクス ○古賀大尚, 能木雅也, 菅沼克昭 (阪大産研)</p>	13:30	<p><b>14C-08</b> ドライバICのスイッチング条件における放射ノイズの評価 ○金子俊之1, 山田耕三2, 関谷雅士2, 高梨哲行2 (1:(株)トッパンNECサーキットソリューションズ1, 2:東芝メディカルシステムズ(株))</p>
13:45	<p><b>14A-11</b> ハイブリッド接合を用いたウエハレベル三次元集積化技術 ○朴澤一幸, 青木真由, 古田 太, 柳沢あづさ, 菊池秀和, 三橋敏郎, 武田健一, 小林治文 (超先端電子技術開発機構)</p>	13:45	<p><b>14B-07</b> アディティブ印刷法を利用したスマートテキストシステムの開発と生体信号モニタリングへの応用 ○井上雅博1, 多田泰徳1, 得丸智弘2 (1:群馬大学, 2:バイオシグナル(株))</p>	13:45	<p><b>14C-09</b> RFパワーアンプの電源ラインのノイズ対策 ○宇田真悟, 金崎昭夫, 田中大介, 三原 恭次, 川口正彦 (村田製作所)</p>
14:00	<p><b>14A-12</b> 100 GByte/sの伝送能力を有する超ワイドバスSiPの開発 ○内山士郎, 坂井 篤, 小林治文, 池田博明 (超先端電子技術開発機構)</p>	14:00		14:00	<p><b>14C-10</b> EMCマイクロモデルの暗号機器へのサイドチャネル攻撃に対する安全性予測への適用 ○五百旗頭健吾1, 天野哲夫1, 岡本 薫1, 豊田啓孝1, 渡辺哲史2 (1:岡山大学大学院自然科学研究科, 2:岡山県工業技術センター)</p>
14:15	<p><b>14A-13</b> ヘテロジニアス三次元集積化技術を用いたRFフロントエンドモジュール ○中澤文彦1, 2, 井上広章1, 2, 勝木隆史1, 2, 中谷忠司1, 2, 山ヶ城尚史1, 2, ミイシャオユウ1, 2 (1:超先端電子技術開発機構, 2:(株)富士通研究所)</p>			14:15	<p><b>14C-11</b> 電磁界シミュレーションによるESDイミュニティの解析 ○賀 文寿1, 秋山雪治1, 白井淳一2 (1:ルネサスエレクトロニクス, 2:日立超LSIシステムズ)</p>
14:30				14:30	

## 第2日目【3月14日】ものづくりセッション D会場

座長：和嶋元世（㈱ JCU）	
10:30	<b>14D-01</b> 低温・短時間硬化型接着剤 ○北村和夫, 徳平英士, 八木友久, 伊達仁昭（富士通クオリティ・ラボ㈱）
10:50	<b>14D-02</b> 短時間焼成可能なフォトシタリングプロセスに適応した導電性銅ナノインクと焼結銅皮膜の特性 ○有村英俊, 濱野 翼, 工藤富雄（石原薬品㈱）
11:10	<b>14D-03</b> $\beta$ -ケトカルボン酸銀塩を用いた低温配線形成技術 ○河染 満（トッパンフォームズ㈱）
11:30	<b>14D-04</b> 耐熱耐光性に優れた脂環式エポキシを用いたLED用封止材 ○鈴木弘世（㈱ダイセル）
11:50	<b>14D-05</b> セミアディティブ対応微細配線形成材料（PF-EL, SAPP） ○小野関仁, 井上 翼, 山岸一次, 金子陽一（日立化成㈱）
12:10	休憩
座長：星 幸紀（㈱大昌電子）	
13:00	<b>14D-06</b> プリントドエレクトロニクス用印刷材料 ○神代 恭, 黒田杏子（日立化成㈱）
13:20	<b>14D-07</b> 熱疲労信頼性と落下衝撃信頼性を両立するECO SOLDER BALL M770の開発 ○立花 賢, 山中芳恵, 吉川俊策, 野村 光（千住金属工業㈱）
13:40	<b>14D-08</b> 過熱水蒸気で焼結する銅ペースト ○佐藤万紀, 小木浩二, 坂本康博, 瀧本豪太（東洋紡㈱）
14:00	<b>14D-09</b> 大量生産が始まった IC, LED パッケージのコンプレッションモールド技術 高瀬慎二, ○徳山秀樹（TOWA㈱）
14:20	<b>14D-10</b> 高機能接着フィルム“アドフレマ” ○飯田英典（ナミックス㈱）

## 第2日目【3月14日】学生・初学者向けチュートリアルセッション E会場

電子機器のものづくりを知ろう！—実装技術を分かり易く説明—

座長：本多 進（よこはま高度実装コンソーシアム）	
10:30	<b>14E-01</b> ①電子機器における電子回路実装の重要性 羽深 等（横浜国立大学）
11:00	<b>14E-02</b> ②回路図に表れないパワー回路混載プリント板実装設計の要点 井上博文（日本電気㈱）
座長：宮代文夫（よこはま高度実装コンソーシアム）	
11:30	<b>14E-03</b> ③プリント配線板の役割とその技術 高木 清（よこはま高度実装コンソーシアム）
12:00	休憩（1時間）
13:00	<b>14E-04</b> ④半導体デバイス・電子部品の実装技術 本多 進（よこはま高度実装技術コンソーシアム）
座長：高木 清（よこはま高度実装技術コンソーシアム）	
13:30	<b>14E-05</b> ⑤モバイル機器を中心とした実装と信頼性技術 八甫谷明彦（㈱東芝）
14:00	<b>14E-06</b> ⑥グリーンパワエレの旗手、SiC パワーデバイスの実装 宮代文夫（よこはま高度実装技術コンソーシアム）

## 第2日目【3月14日】イベント

### 【表彰式】

時間：14:30～14:50

場所：講義棟 B 大教室

### 【特別講演】

時間：15:00～17:00

場所：講義棟 B 大教室

座長：小柳光正（東北大学）

#### ◆特別講演 1

「日本のモノづくり革命—歴史的転換点に立って—」

田中千秋（たなか ちあき）氏

東レ株式会社 相談役

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社 代表取締役会長

#### ◆特別講演 2

「体内植込み型補助人工心臓「EVAHEART」の開発」

山崎俊一（やまざき しゅんいち）氏

株式会社サンメディカル技術研究所 取締役会長

### 【交流会】

時間：17:30頃より1時間半程度

場所：川内北キャンパス学生食堂



第3日目 (3月15日) 講演セッション (1/3)

【A会場】		【B会場】		【C会場】		【E会場】	
10:30	<p>「マイクロメカトロニクス実装技術」 座長：張 毅 (産業技術総合研究所) <b>15A-01 依頼講演</b> メートル級大面積マイクロシステム実装布帛 ○高松誠一 (産総研)</p>	10:30	<p>「プリンタブルデバイス実装」 座長：土門孝彰 (TDK(株)) <b>15B-01 依頼講演</b> ハイドロゲルへの電極形成と応用 ○西澤松彦 (東北大院工)</p>	10:30	<p>「高速高周波・電磁特性技術」 座長：岡 尚人 (三菱電機(株)) <b>15C-01</b> 液晶ポリマーフィルムの複素比誘電率の温度依存性測定 ○常光理志1, 小林禎夫2, 小野寺 稔3 (1:埼玉大, 2:サムテック(有) 3:㈱クラレ)</p>	10:30	<p>「環境調和型実装技術」 座長：石井利昭 (㈱日立製作所) <b>15E-01 依頼講演</b> IT融合による次世代スマートエネルギーシステム ○田中泰光, 下位法弘, 三ヶ田伸也, 田路和幸 (東北大学)</p>
				10:45	<p><b>15C02</b> 平衡形円板共振器を用いた3~26 GHzにおける複素比誘電率測定 ○中堤 純1, 小林禎夫2, 川原祐紀3 (1:埼玉大, 2:サムテック(有), 3:川島製作所(株))</p>		
11:00	<p><b>15A-02</b> サイズフリーMEMS-IC集積化のためのC2Wセルフアライメントと仮接合 ○中野裕太1, 魯 健2, 高木秀樹2, 前田龍太郎2, 早瀬仁則1 (1:東京理科大学大学院, 2:産総研集積マイクロ研究センター)</p>	11:00	<p>座長：西田秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支援) <b>15B-02 依頼講演</b> プリントド・エレクトロニクス：ナノ材料と透明配線技術 ○菅沼克昭, 能木雅也, 長尾至成, 菅原 徹, 古賀大尚, 酒 金婷 (大阪大学)</p>	11:00	<p><b>15C-03</b> 5 GHz 帯パワーアンプのモジュール化 ○宮川晃尚1, 内田祐介1, 金谷晴一2, 兼本大輔2, 山下勇輝2 (1:中央電子工業(株), 2:九州大学大学院システム情報科学研究院)</p>	11:00	<p><b>15E-02 依頼講演</b> 新しい省エネルギーデバイス：平面照明 ○下位法弘, 北條俊昌, Ledezma Adriana, Sharon Marie, 田中泰光, 田路和幸 (東北大学院)</p>
11:15	<p><b>15A-03</b> リールツーリールによる環境発電用基材形成プロセスの開発 ○山下崇博1, 高松誠一1, 2, 小林健1, 2, 伊藤寿浩1, 2 (1:BEANS 研, 2:産総研)</p>			11:15	<p><b>15C-04</b> CISPR25に基づく低周波伝導ノイズの電磁界シミュレーション手法の検討 ○上田千寿 (㈱エーイーティー)</p>		
11:30	<p><b>15A-04</b> GaAs/SiC直接ウェハ接合を用いた光デバイスの高放熱構造 ○中筋香織, 日暮栄治, 須賀唯知 (東京大学)</p>	11:30		11:30	<p><b>15C-05</b> 左手系導波管を用いたミリ波帯スロットアレーアンテナの基礎検討 ○小松真奈, 山本隆彦, 越地耕二 (東京理科大)</p>	11:30	<p><b>15E-03</b> 環境負荷低減型の液晶ポリマー用接着剤の開発 ○松土和彦 (㈱ADEKA)</p>
11:45	<p><b>15A-05</b> 真空紫外光照射を利用した金属、樹脂基板の大気圧混載接合 ○重藤暁津1, マノアジャヤン1, 水野潤2 (1:物材機構, 2:早稲田大学)</p>			11:45	<p><b>15C-06</b> 電磁界共振結合によるボディアエリア通信の検討 - 詳細人体腕部モデルを用いた伝送特性および電磁界分布の検討 - ○越地福朗1, 湯山菜奈子1, 越地耕二2 (1:国士館大学1, 2:東京理科大学)</p>	11:45	<p><b>15E-04</b> 外部熱入力方式の相違による金属細線を用いた熱電回路の熱起電力について ○渡邊彬仁, 燈明泰成 (東北大院)</p>
12:00	<p><b>15A-06</b> 三次元構造物への任意のパターニングおよび3Dフォトマスクの開発 ○林 政寛1, 2, 3, 張 毅1, 2, 高木秀樹1, 2, 早瀬仁則1, 3, 伊藤寿浩1, 2 (1:BEANS 研究所 Micro BEANS センター, 2:産業技術総合研究所, 3:東京理科大学)</p>	12:00	休憩	12:00	休憩	12:00	<p><b>15E-05</b> Bi-Ag系高温鉛フリーはんだへの元素添加による延性改善 ○下田将義1, 山川智弘1, 塩川国夫2, 西川 宏1, 竹本 正1 (1:大阪大学接合科学研究所, 2:富士電機(株))</p>
12:15   13:00	休憩					12:15   13:00	休憩
		13:00		13:00			

第3日目 (3月15日) 講演セッション (2/3)

	[A会場]		[B会場]		[C会場]		[E会場]
13:00	<p>「マイクロメカトロニクス実装技術」 座長：重藤暁津 (独) 物質材料研究機構 15A-07 ポリマー基板における高アスペクト比貫通孔の高速めっき法 ○ Zhu Qingsheng, Zhang Yui, Itoh Toshihiro, Maeda Ryutaro (産業技術総合研究所)</p>	13:00	<p>「パワーエレクトロニクス実装」 座長：柳浦 聡 (三菱電機 (株)) 15B-03 Si デバイスのほんだ実装における Au (Ag) レスプロセスの開発 ○中牟田雄, 曲 拓, 木村 勲, 樋口 靖, 鄒 弘綱 (株アルバック)</p>	13:00	<p>「高速高周波・電磁特性技術」 座長：高橋丈博 (拓殖大学) 15C-07 3G スマートフォンに組み込んだ UWB アンテナ ○秋山侑祐 1, 越地福朗 1, 越地耕二 2 (1: 国士舘大学, 2: 東京理科大学)</p>	13:00	<p>「配線板製造技術」 座長：加藤義尚 (福岡大学) 15E-06 銅穴埋めめっきにおけるジアルルアミン系レベラーの作用 ○阿南善裕 1, 竹内 実 1, 2, 岡本尚樹 1, 齊藤丈靖 1, 文屋 勝 2, 横井昌幸 1, 近藤和夫 1 (1: 大阪府立大学, 2: 日東紡績(株))</p>
13:15	<p>15A-08 らせん巻きフィルムを用いた高機能・多機能なカテーテル・内視鏡の開発 ○松永忠雄 1, 石代宗之 2, 芳賀洋一 2 (1: 東北大学 <math>\mu</math> SIC, 2: 東北大学)</p>	13:15	<p>15B-04 Ni 密着層を用いた Cu ナノ粒子無加圧接合 ○明渡邦夫, 石崎敏孝, 佐藤敏一 (豊田中研)</p>	13:15	<p>15C-08 電子機器搭載を考慮した広帯域アンテナ—筐体コーナ部への実装時の放射特性— ○櫻井 佑, 山本隆彦, 越地耕二 (東京理科大)</p>	13:15	<p>15E-07 低抵抗微細銅配線形成のためのジアルルアミン系添加剤を用いた電気銅めっきの検討 ○吉田悠佑 1, 大貫 仁 2, 竹内 実 3, 岡本尚樹 1, 齊藤丈靖 1, 文屋 勝 3, 横井昌幸 1, 近藤和夫 1 (1: 阪府大, 2: 茨大, 3: 日東紡績(株))</p>
13:30	<p>15A-09 Au 薄膜を用いた大気中のウエハ室温接合における大気暴露時間と接合性能 ○今 一恵, 魚本 幸, 島津武仁 (東北大学)</p>	13:30	<p>15B-05 Cu/Ni 界面の形成過程 ○佐藤敏一, 明渡邦夫, 石崎敏孝 (豊田中研)</p>	13:30	<p>15C-09 扇形と台形放射素子を用いた UWB 用広帯域アンテナのプリント配線板化の検討 ○平栗一也 1, 越地福朗 1, 越地耕二 2 (1: 国士舘大学, 2: 東京理科大学)</p>	13:30	<p>15E-08 電気銅めっきにおける促進作用に与える一価銅の影響 ○濱崎公太, 岡本尚樹, 齊藤丈靖, 横井昌幸, 近藤和夫 (阪府大)</p>
13:45	<p>15A-10 Ti 薄膜を用いたウエハの室温接合技術における Ti 膜厚と接合性能 ○魚本 幸, 今 一恵, 島津武仁 (東北大)</p>	13:45	<p>15B-06 高温動作パワーモジュールに向けた SiC パワーデバイスの両面電極接合技術 ○加藤史樹, 郎 豊群, SIMANJORANG Rejeki, 仲川 博, 山口 浩, 佐藤 弘 (産総研)</p>	13:45	<p>15C-10 人体腕部における組織構造を考慮した電磁ファントムの電気定数に関する検討 ○村松大陸 1, 越地福朗 2, 越地耕二 3, 佐々木 健 1 (1: 東大, 2: 国士舘大, 3: 東京理科大)</p>	13:45	<p>座長：雀部俊樹 (雀部技術事務所) 15E-09 高アスペクト比ビアにおける Cu めっきの初期成長に関する微量 Sn 添加の影響評価 ○赤澤美雪 1, 2, 齋藤美紀子 3, 藤本興治 1, 鈴木浩助 1, 倉持 悟 1 (1: 大日本印刷(株), 2: 技術研究組合 NMEMS 技術研究機構, 3: 早稲田大学)</p>
14:00	<p>休憩</p>	14:00	<p>15B-07 Cu-Sn 遷移的液相焼結 (TLPS) 接合の高温保持における信頼性 ○郎 豊群, 加藤史樹, 仲川 博, 山口 浩, 佐藤 弘 (産総研)</p>	14:00	<p>15C-11 3-D SiP モジュール構造を用いた 60 GHz 帯 2×4 素子アレーアンテナ ○鈴木祐也, 吉田賢史, 谷藤正一, 亀田 卓, 末松憲治, 高木 直, 坪内和夫 (東北大)</p>	14:00	<p>15E-10 スパッタリング CuNi 合金シード層を用いた Cu めっき配線基板の開発 ○山崎智生, 坂口勇太, 堀内道夫 (新光電気工業(株))</p>
14:15	<p>「信頼性解析技術」 座長：廣畑賢治 (株東芝) 15A-11 信頼性保証の課題—最近の事故の反省から— ○津久井勤 (リサーチラボ・ツクイ)</p>	14:15	<p>15B-08 プリント配線板上に形成したスパイラルコイルによるワイヤレス電力伝送—巻線パターンの工夫による結合係数向上— ○今野宗一郎, 山本隆彦, 越地耕二 (東京理科大)</p>	14:15	<p>15C-12 近くに金属片があるコイル間の無線電力伝送の解析 ○菊地秀雄 (ST-Lab)</p>	14:15	<p>15E-11 印刷とめっきの組み合わせによる金属微細パターンの作製 ○尾上美紀 1, 所和彦 1, 牛島洋史 1, 近間克己 2, 小島圭介 2 (1: 産総研, 2: 日産化学)</p>
		14:30	<p>休憩</p>	14:30	<p>休憩</p>	14:30	<p>休憩</p>

第3日目 (3月15日) 講演セッション (3/3)

	[A会場]		[B会場]		[C会場]		[E会場]
14:45	<b>15A-12</b> 半導体三次元実装構造用微細貫通配線の強度信頼性評価 ○古屋亮輔, 鈴木 研, 三浦英生 (東北大)	14:45	<b>「パワーエレクトロニクス実装」</b> 座長: 畠山友行 (富山県立大学) <b>15B-09</b> SiCパワーモジュールのための耐熱樹脂ベンチマーク試験 ○谷本 智1, 2, 谷澤秀和1, 3, 渡辺衣世1, 松井康平1, 4, 佐藤伸二1, 3 (1:FUPET, 2:日産自動車㈱, 3:サンケン電気㈱, 4:富士電機㈱)	14:45	<b>「光回路実装技術」</b> 座長: 小林潤也 (NTT) <b>15C-13 依頼講演</b> 光配線接続のための自己形成光導波路技術 ○三上 修 (東海大学)	14:45	<b>「配線板製造技術」</b> 座長: 和嶋元世 (㈱ JCU) <b>15E12</b> 超微細メンブレン配線板の開発 ○鳥井純一1, 小清水和敏1, 八木橋亮2 (1:㈱フジクラ, 2:㈱青森フジクラ金矢)
15:00	<b>15A-13</b> めっき銅薄膜配線の結晶品質評価手法の開発 ○範 伝紅, 鈴木 研, 三浦英生 (東北大)	15:00	<b>15B-10</b> パワーデバイス用裏面電極の耐熱性に関する研究 ○田口 勇, 八坂慎一, 三橋雅彦, 本泉佑, 菅我雅康, 篠原俊朗 (神奈川県産技ゼ)			15:00	<b>15E-13</b> 平滑配線用密着層を保護するビア形成技術 ○佐々木伸也, 谷 元昭 (㈱富士通研究所)
15:15	<b>15A-14</b> 結晶品質制御によるめっき銅薄膜配線の信頼性向上 ○浅井 修, 鈴木 研, 三浦英生 (東北大)	15:15	<b>15B-11</b> 伝熱材料を評価するための新しい手法 ○斎藤靖弘, 辻 裕樹, 江元博幸, 小室貴紀 (神奈川県立工科大学)	15:15	<b>15C-14</b> 光メタマテリアルの金ナノ構造における製作誤差の評価 ○穂苅遼平, 金森義明, 羽根一博 (東北大学大学院)	15:15	<b>15E-14</b> レーザーによる樹脂表面改質技術を用いたMID ○齋藤裕一1, 湯本哲男2, 菅野 信3, 目黒和幸4, 渡辺充広1 (1:㈱日本表面処理研究所, 2:三共化成㈱, 3:三共精密金型㈱, 4:地方独立行政法人岩手県工業技術センター)
15:30	<b>15A-15</b> 配線の低電気抵抗率化と高信頼化 ○木村康裕, 坂 真澄 (東北大学)	15:30	<b>15B-12</b> 冷媒の自然循環方式によるデータセンター冷却電力の省エネ化 ○稲葉賢一, 小路口暁, 千葉正樹, 松永有仁, 坂本 仁, 吉川 実 (NECグリーンプラットフォーム研究所)	15:30	<b>15C-15</b> ディスペンサ法によるGI型ポリマー並列光導波路の高精度ピッチ制御 ○田口竜生1, 相馬一友2, 石樽崇明1 (1:慶應義塾大学理工学部, 2:慶應義塾大学大学院2)	15:30	
15:45	<b>15A-16</b> 放射光X線ラミノグラフィを用いたフリップチップはんだ接合部における疲労き裂進展過程のモニタリングの可能性評価 ○釣谷浩之1, 佐山利彦1, 岡本佳之2, 高柳 毅2, 上杉健太郎3, 星野真人3, 森 孝男4 (1:富山県工業技術センター, 2:コーセル㈱, 3:高輝度光科学研究センター, 4:富山県立大学)	15:45	<b>15B-13</b> 相変化冷却器における放熱部の最適な設計手法 小路口暁, ○蜂矢真弘, 吉川 実, 坂本 仁, 千葉正樹, 稲葉賢一, 松永有仁 (NEC)	15:45	<b>15C-16</b> ディスペンサを用いたシングルモードポリマー光導波路の作製 ○菅沼大輔1, 相馬一友2, 石樽崇明1 (1:慶應義塾大学理工学部, 2:慶應義塾大学大学院理工学研究科)		
16:00	<b>15A-17</b> 高温劣化を考慮したはんだ接合部の疲労寿命予測手法 ○河野賢哉1, 中 康弘1, 谷江尚史1, 木本良輔2, 山本健一2 (1:㈱日立製作所日立研究所, 2:ルネサスエレクトロニクス㈱)	16:00	<b>15B-14</b> 複数発熱体に対する各種冷却方式の優位性検証 ○千葉正樹, 坂本 仁, 小路口暁, 稲葉賢一, 松永有仁, 吉川 実 (NEC)	16:00	座長: 杉原興浩 (東北大学) <b>15C-17</b> 高バンド幅インターコネク用光電気コネクタ ○平洋一, 沼田英俊, 山田文明 (日本IBM東京基礎研)		
16:15		16:15		16:15	<b>15C-18</b> 低コストパラレル光インターコネクションのリンク検証 屋敷健一郎, ○柳町成行, 蔵田和彦 (NEC)		
				16:30	<b>15C-19</b> KTN高速光スキャナを用いた波長掃引速度200kHz光源の開発 ○小林潤也1, 佐々木雄三1, 岡部勇一1, 上野雅浩1, 坂本 尊1, 豊田誠治1, 大宮孝太2, 近江雅人2 (1:NTTフォトニクス研究所, 2:大阪大学)		
				16:45			

### 第3日目【3月15日】ものづくりセッション D会場

座長：高木 清 (YJC)	
10:30	<b>15D-01</b> フジクラの部品内蔵多層 FPC WABE Package® ○南條宏和, 岡本誠裕, 糸井和久, 上田啓貴, 奥出 聡, 中尾 知 (㈱フジクラ)
10:50	<b>15D-02</b> 一括積層工法 (PALAP) による超高多層基板の開発とその展開 ○横地智宏 (㈱デンソー)
11:10	<b>15D-03</b> LPKF 社の配線板へのレーザ技術の応用について ○藤村 迅 (日本エルピーケーエフ㈱)
11:30	<b>15D-04</b> 絶縁材料への無電解銅めっき密着増強への挑戦：物理から化学密着へ ○仙波幸治 1, マガヤタファズワ 2, 向井賢一郎 2, ブラントルツツ 2, イースタップブライアン 2, シェメン 2 (1:アトテックジャパン, 2:アトテック USA2)
11:50	<b>15D-05</b> ピアフィリング用硫酸銅めっき添加剤「トップルチナシリーズ」 ○渡邊裕文 (奥野製薬工業㈱)
12:10	休憩
座長：中尾 知 (㈱フジクラ)	
13:00	<b>15D-06</b> ポリイミド上への直接メタライジング技術 ELFSEED プロセス ○中丸弥一郎, 福本ユリナ, 高德 誠, 君塚亮一 (㈱JCU)
13:20	<b>15D-07</b> 高速プラズマエッチング装置によるフレキシブル両面基板の低温処理 上山浩幸, 深沢信司, ○浅野敬祐 (㈱JCU)
13:40	<b>15D-08</b> ファインピッチ CSP 向け部分補強工法 'PAC-Fill 工法' ○佐伯 翼 1, 圓尾弘樹 1, 境 忠彦 1, 加藤哲也 2, 松川容三 2 (1:パナソニック ファクトリーソリューションズ㈱, 2:パナソニック㈱)
14:00	<b>15D-09</b> 一液フラックス洗浄システム マイクロクリーナーECO ○神保拓郎 (化研テック㈱)
14:20	<b>15D-10</b> 最新 UV レーザードリル装置 Emerald-150 のご紹介 ○利光浩二 (日本オルボテック㈱)
14:40	休憩
座長：上原利久 (㈱トッパン NEC サーキットソリューションズ)	
14:55	<b>15D-11</b> 次世代プリント配線板に向けたドリル及びレーザ穴加工技術 ○久世 修 (日立ビアメカニクス㈱)
15:15	<b>15D-12</b> 高精度ステレオ方式による高速マイクロバンプ測定装置 MB-3000 ○鈴木一嘉 (東レエンジニアリング㈱)
15:35	<b>15D-13</b> 過渡熱測定による放熱構造の可視化分析と応用 ○羅 亜非 (メンター・グラフィックス・ジャパン㈱)
16:55	<b>15D-14</b> 先端半導体パッケージ不具合の非破壊解析 ○松崎富夫, 平本正己, 小杉智之 (㈱テラミクロス)
16:15	<b>15D-15</b> 三次元実装で必須となるバウンダリスキャンテスト技術 ○亀山修一 1, 2, 高橋 寛 2 (1:富士通㈱, 2:愛媛大)

### 第3日目【3月15日】キャンパスツアー (参加者は事前予約が必要)

1回目 13:30 ~ 15:00	東北大学片平キャンパス内の研究所の見学 定員 40名
2回目 15:15 ~ 16:45	同上 定員 40名